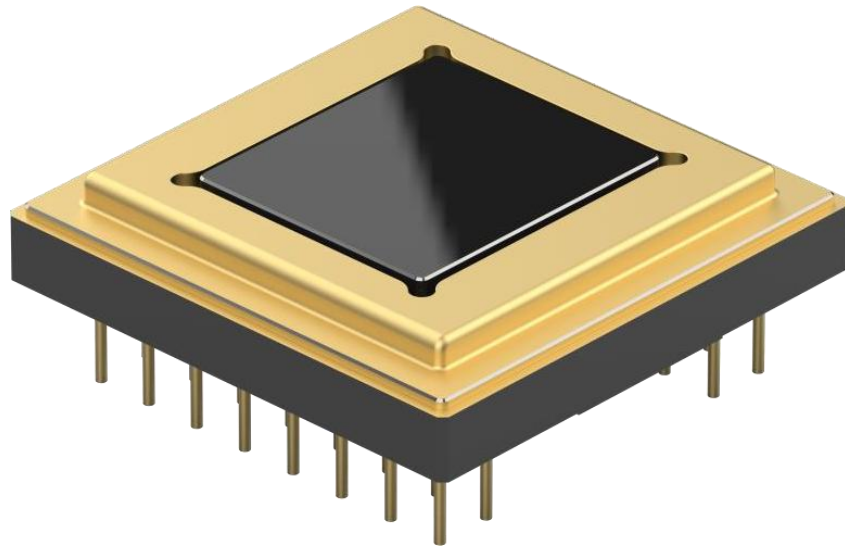




V1.0

非制冷陶瓷封装红外探测器 12 μ m

规格书

TM12

产品介绍

TM12 是一款 12um 像元距 384x288/640x512 阵列非制冷红外探测器读出芯片。其特性是低 NETD，高可靠性，体积小，重量轻，功耗低，适用于长波红外辐射成像。该探测器主要由硅读出电路(ROIC)、氧化钒红外传感器阵列和陶瓷管壳组成。兼顾灵敏度、均匀性及性价比，适应于多种应用场景。高集成度，大幅度降低 BoM 成本，简单易用，优异的时间、空间噪声，通过各种降噪技术，最大限度减少噪声的影响。较低的芯片功耗，并可工作于低功耗模式(<100mW)，全面的片上失调校正功能，确保高动态范围测温成像能力，无 TEC 低温漂输出，简化外部标定校正操作，内置温度传感器，可数字输出芯片温度。

主要特点

- ◆ 384x288/640x512 阵列规模
- ◆ 12μm 像元尺寸
- ◆ 帧频 25~60Hz
- ◆ NETD<35mK@50fps
- ◆ 热时间常数<12ms
- ◆ 低功耗<130mW@50Hz
- ◆ 简单供电，VSK=4.6V(典型)，VDDA=3.6V，VDDD=1.8V
- ◆ 小尺寸封装，陶瓷无 TEC 封装
- ◆ 数字接口，带同步时钟的 4 端口 16bit
- ◆ 数字输出，4bit 单端口输入像素 OCC，
- ◆ 外部帧同步及异步复位，<100MHz 输入时钟@60fps

应用场景

观瞄，工业测温，安防监控，消防营救，车载夜视，建筑检测，医疗健康

产品参数

产品型号	TM12	
探测器类型	非制冷氧化钒红外探测器	
分辨率	384 x 288	640 x 512
像元尺寸	12μm	
热时间常数	10ms	
响应波段	8~14μm	
噪声等效温差 (NETD)	<35mK (F#/1.0, 50Hz, 300K)	
帧频	25Hz/30Hz/50Hz/60Hz	
读出方式	逐行读出	
输出方式	14bit 数字输出	
封装方式	32 引脚真空封装 (陶瓷)	
功耗	<130mW@50Hz	
工作温度	-40°C~85°C	
尺寸	/	
重量	/	

深圳灵卡技术科技有限公司

 0755-26405987/13928470627 www.link-card.com sales@link-card.com 深圳市宝安区沙井中心路金达城大厦 8 楼 8L